Linking your dreams
リンテック株式会社

Creating the Future with Adhesive Technologies

Linkage + Technology
LINTEC

夢をカタチにする粘着技術のリンテック

代表取締役社長
社長執行役員　西尾 弘之

2015.3

会社概要

■本　社　　東京都板橋区

■証券コード　7966（東証1部）

■設　立　　1934年（昭和9年）10月15日

■資本金　　232億円（14年3月末）

■従業員数　4,223人（14年3月末）：連結

■売上高　　2,032億円（14年3月期）：連結

■決算日　　3月31日

■事業内容　粘着製品、粘着関連機器、特殊紙、
剥離紙・剥離フィルムなどの開発・製造・販売

■事業拠点　国内連結子会社：　3社
海外連結子会社：30社

沿革 ①

1934年
（昭和　9年）

ガムテープメーカー 「不二紙工株式会社」
設立（東京・板橋） ※1984年 FSK株式会社に商号変更

1960年
（昭和35年）

ラベル用粘着紙・粘着フィルムの
製造・販売を開始

以降、屋内外装飾、二輪・自動車関連などの
工業分野に粘着事業を拡大

1986年
（昭和61年）

UV硬化型ダイシングテープを開発し、
半導体関連分野に本格参入

1987年
（昭和62年）

米国のマディコ社を子会社化

1990年
（平成 2年）

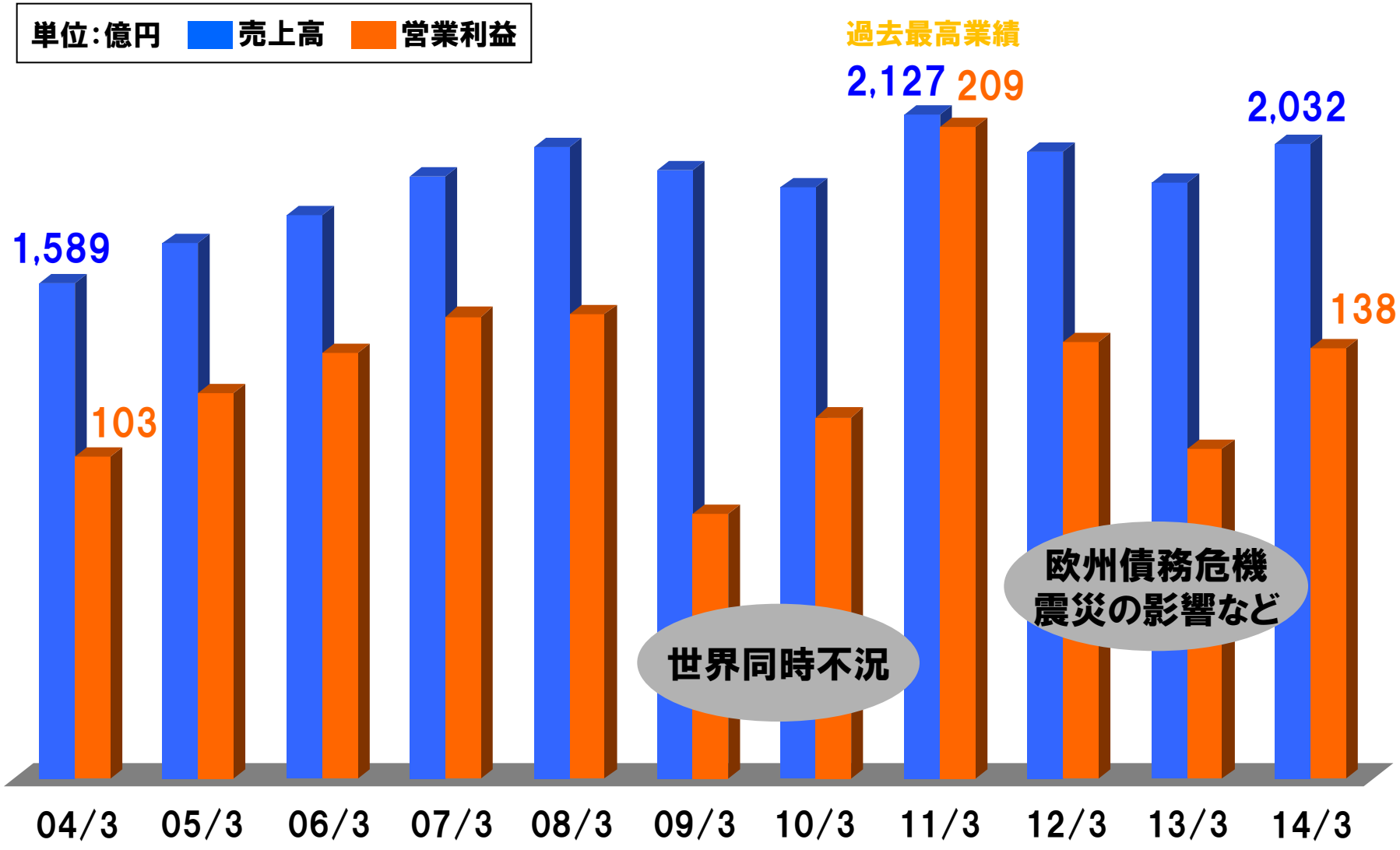
四国製紙、創研化工と合併
「リンテック株式会社」に商号変更

特殊紙、剥離紙・剥離フィルムから粘着紙・
粘着フィルム、関連機器分野にまで業容を拡大

沿革 ②

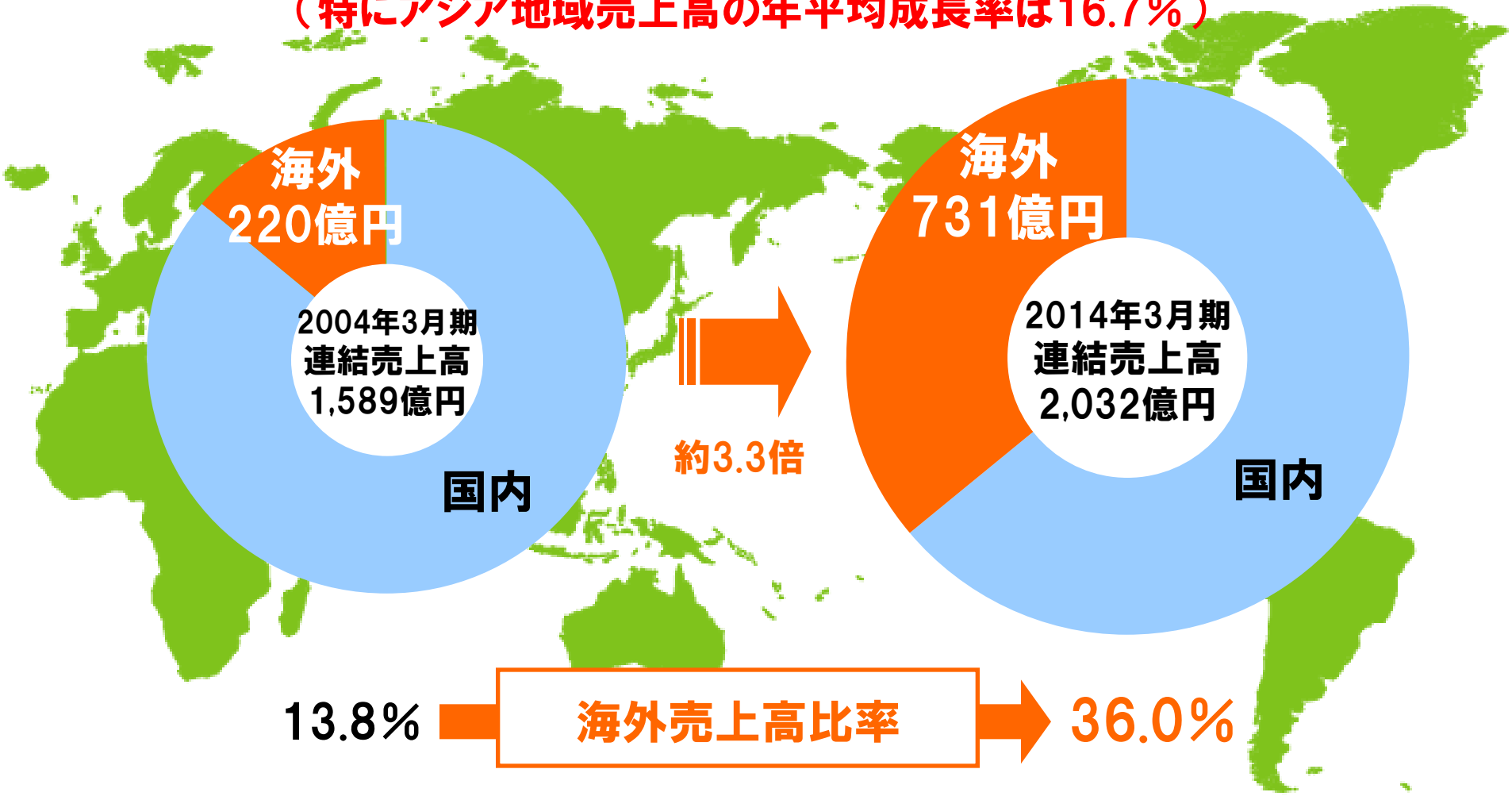
1991年（平成 3年）	液晶関連分野に本格参入
1993年（平成 5年）	琳得科（天津）実業有限公司を設立
1994年（平成 6年）	リンテック・インドネシア社を設立
2000年（平成12年）	リンテック・インダストリーズ（マレーシア）社を設立
2002年（平成14年）	琳得科（蘇州）科技有限公司を設立 リンテック・スペシャリティー・フィルムズ（韓国）社を設立
2003年（平成15年）	リンテック・スペシャリティー・フィルムズ（台湾）社を設立
2004年（平成16年）	リンテック・コリア社を設立
2011年（平成23年）	リンテック・タイランド社を設立
2015年（平成27年）	リンテック・アジアパシフィック社を設立

業績推移／売上高、営業利益

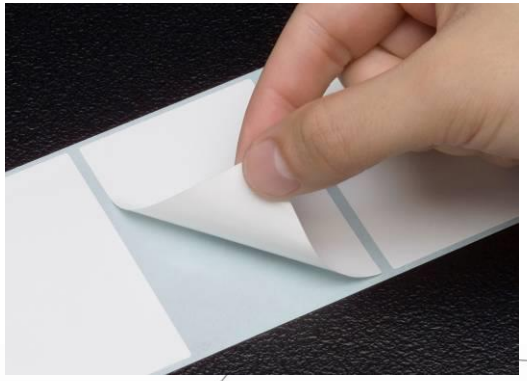


業績推移／海外売上高

直近10年間で511億円増加、年平均成長率12.8％
（特にアジア地域売上高の年平均成長率は16.7％）



粘着製品の基本構成



●表面加工
印刷・印字適性、耐久性など

●表面基材
（紙・フィルム）

粘着剤●

剥離紙・剥離フィルム●

トータルに自社技術で対応

四つの基盤技術と事業セグメント

基盤技術

1. 粘着応用技術
2. 表面改質技術
3. システム化技術
4. 特殊紙・剥離材製造技術

印刷材・産業工材関連

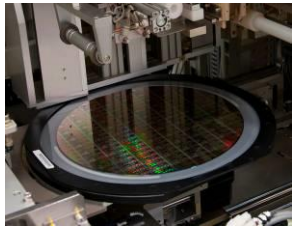
・印刷・情報材事業部門

・産業工材事業部門

電子・光学関連

・アドバンストマテリアルズ事業部門

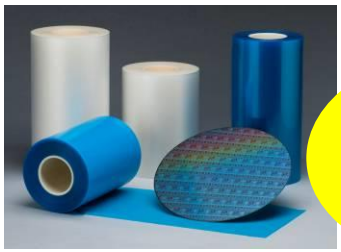
・オプティカル材事業部門



洋紙・加工材関連

・洋紙事業部門

・加工材事業部門

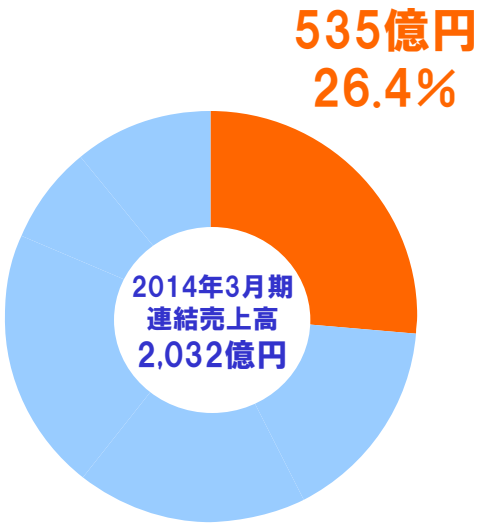


粘着素材
＋
関連機器

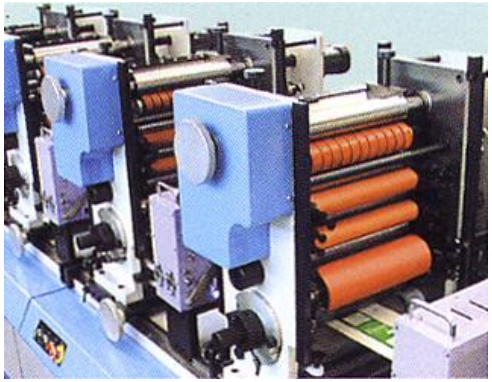
印刷・情報材事業部門

●ラベル用粘着紙・粘着フィルム

- ●粘着剤によって、永久接着タイプ・再剥離タイプ・再貼付タイプに分けられる
- ●印刷・印字適性、耐久性、耐熱性、耐水性、低温適性、曲面貼付性、寸法安定性、意匠性などに優れ、さまざまな用途や使用環境に対応



●ラベル印刷機　など



■ラベル用粘着紙・粘着フィルムの用途／主な要求性能

●日用品関連

- 耐水性
- 曲面貼付性
- 意匠性

●食品関連

- 耐水性
- 曲面貼付性
- 低温適性

●文具関連

- 耐久性
- 寸法安定性
- 意匠性

●流通関連

- 印字適性
- 捺印適性
- 低温適性

●医療・医薬関連

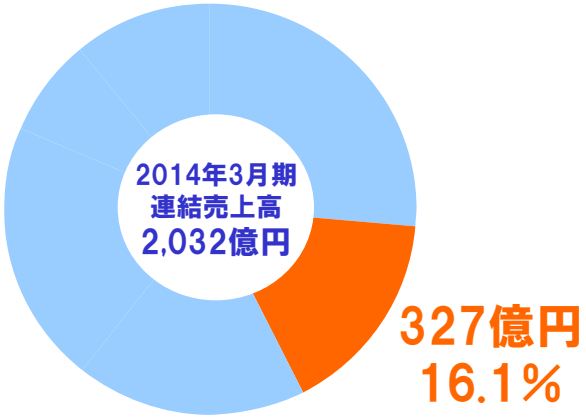
- 印刷・印字適性
- 耐薬品性
- 改ざん防止機能

●工業関連

- 耐油・耐水性
- 耐久性
- 耐熱性

産業工材事業部門

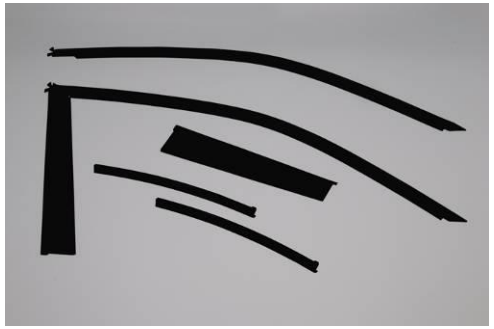
- ●ウインドーフィルム
- ●屋外看板・広告用フィルム
- ●内装用化粧シート
- ●自動車用粘着製品
- ●工業用粘着テープ
- ●ラベリングマシン　など



●自動車用粘着製品

●ドアサッシ用塗装代替フィルム ▶▶▶

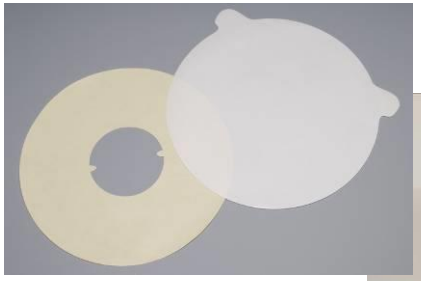
独自の材料設計によって、
空気を抜けやすくし、貼付を容易に



空気の入った状態

空気のない状態

●アルミホイール用保護フィルム



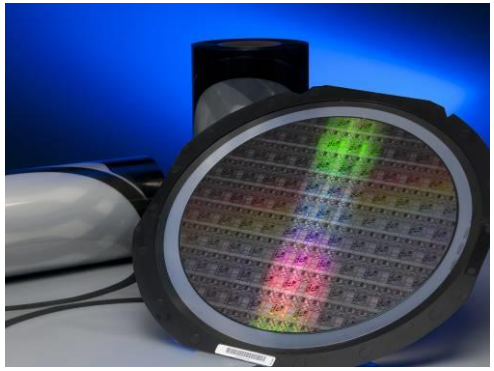
●マーキングフィルム

●ウインドーフィルム

アドバンストマテリアルズ事業部門

- 半導体関連粘着テープ
- 半導体関連装置
- 積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム
- タッチパネル関連製品　　など

368億円
18.1%



■半導体チップの製造工程

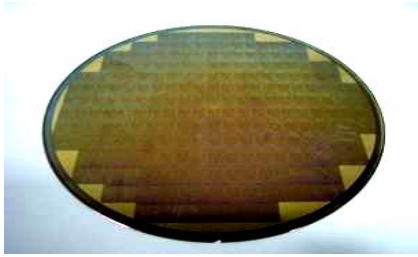
【前工程】

単結晶シリコン
インゴット

→

ウェハ

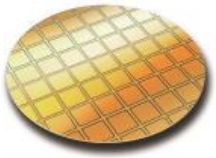
→



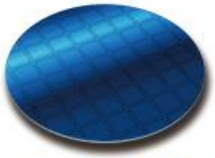
回路形成ウェハ

【後工程】

※当社テープ・装置を使用



回路形成
ウェハ



表面保護
テープ貼付

裏面研磨
（薄型化）

ダイシング
テープ貼付

表面保護
テープ剥離

ダイシング
（ウェハ切断）

テープへの
紫外線照射

ピックアップ

実装

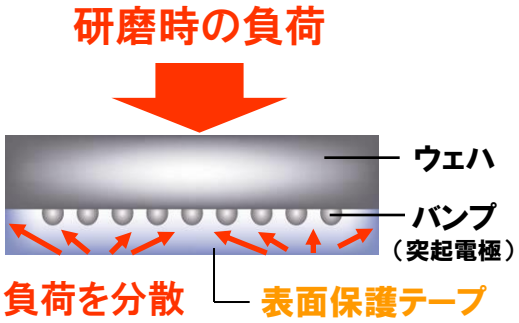
樹脂封止

●半導体関連粘着テープ／注力製品

●極薄・ハイバンプウェハ対応表面保護テープ

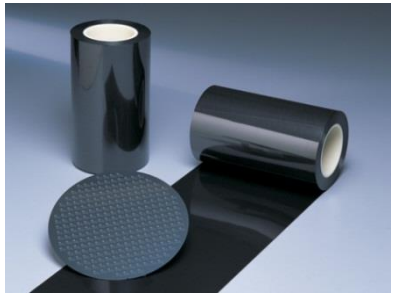
- 回路面にバンプと呼ばれる突起電極を形成したウェハの裏面研磨時に使用するテープ
- 回路面に形成されたバンプの凹凸にも、すき間なく貼ることができ、ウェハ表面の汚染を防止
- ウェハにかかる研磨時の負荷を分散して破損を抑制
- 特殊設計により、研磨後の薄型ウェハの反りを抑制

■裏面研磨工程

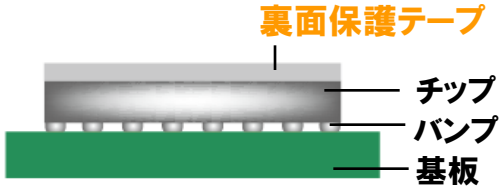


●フリップチップ裏面保護テープ

- フリップチップ実装時に裏面を保護・補強するテープ
- 回路面への光透過を抑制し、回路面への悪影響を低減
- 厚みの均一性に優れ、作業工程を簡略化
- デバイスからの発熱を外部に放熱するタイプや、赤外線を透過するタイプもラインアップ

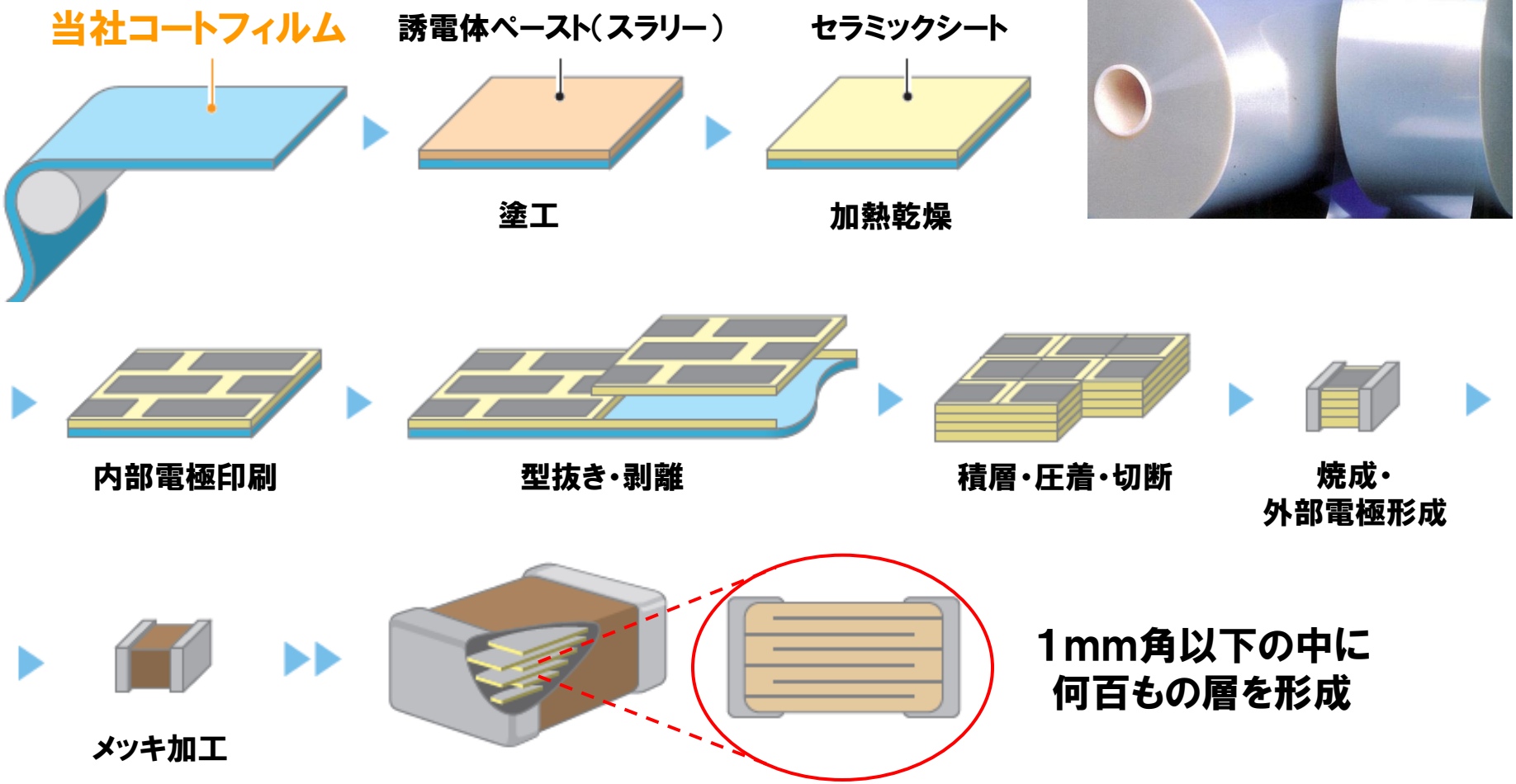


■フリップチップ実装



●積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム

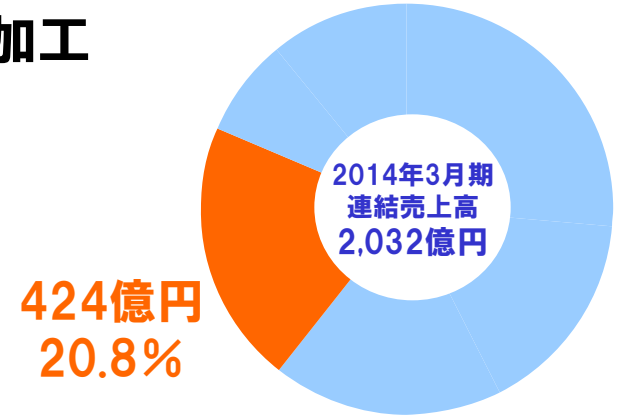
■積層セラミックコンデンサーの製造工程

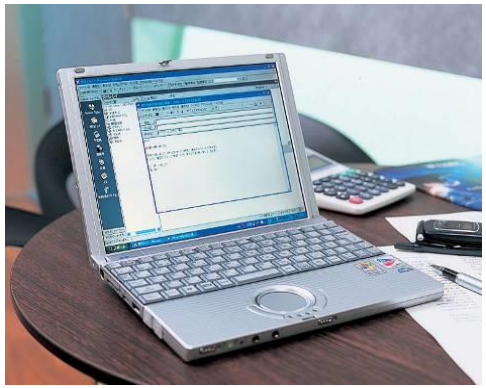


1mm角以下の中に
何百もの層を形成

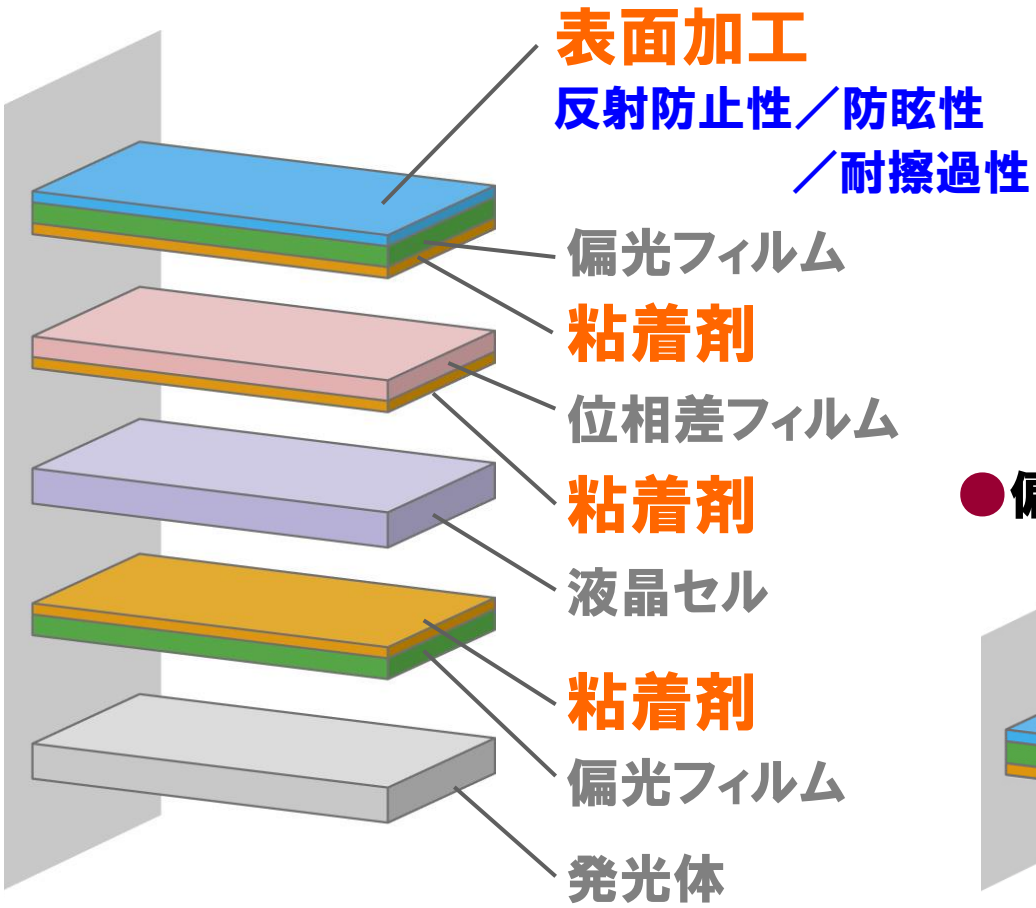
オプティカル材事業部門

- 液晶用偏光・位相差フィルム ／粘着加工
- 液晶用偏光フィルム ／表面加工
- 偏光フィルム用保護フィルム　など

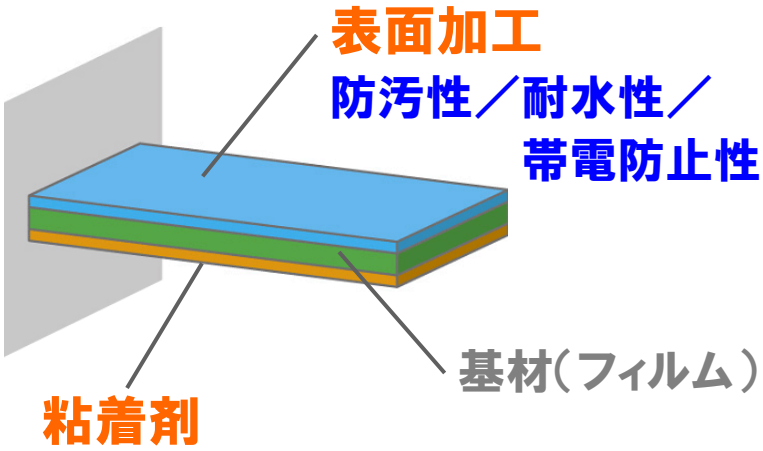




■液晶ディスプレイの構成

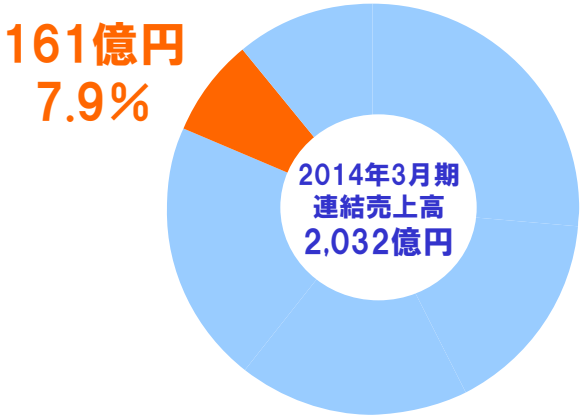


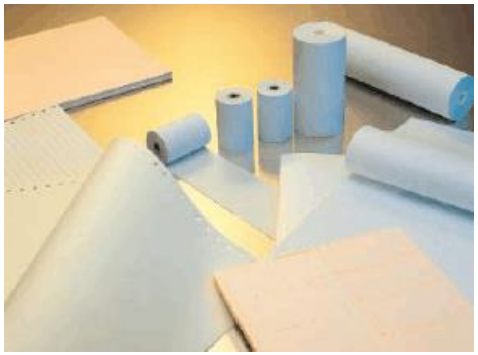
●偏光フィルム用保護フィルム



洋紙事業部門

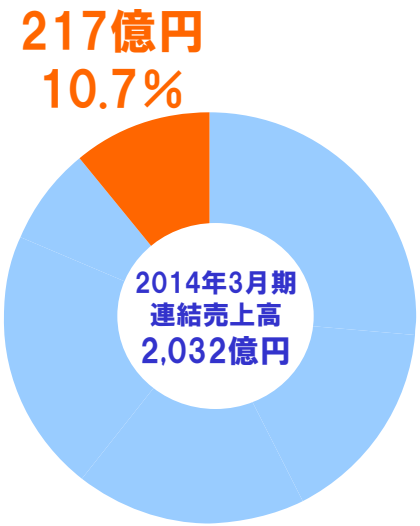
- カラー封筒用紙
- 色画用紙
- 特殊機能紙（無塵紙、耐油紙など）
- 高級印刷用紙
- 高級紙製品用紙　など

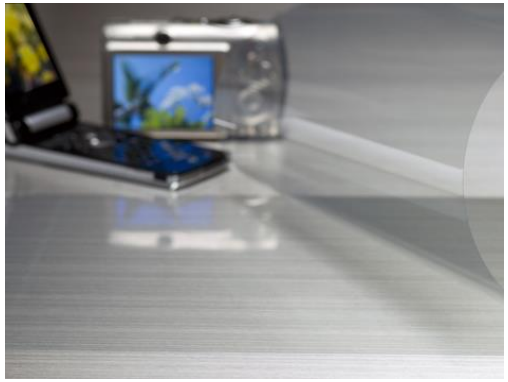




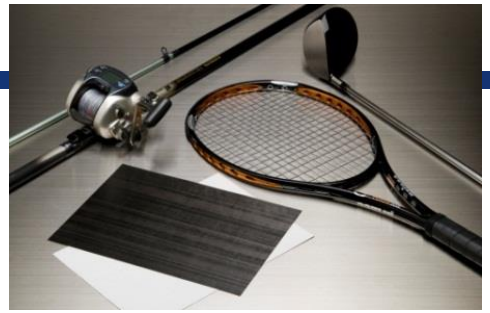
加工材事業部門

- 粘着用剥離紙
- 光学関連製品用剥離フィルム
- FPC*カバーレイ用剥離紙
- 合成皮革用工程紙（剥離紙）
- 炭素繊維複合材料用工程紙（剥離紙）など





*FPC = フレキシブルプリント基板



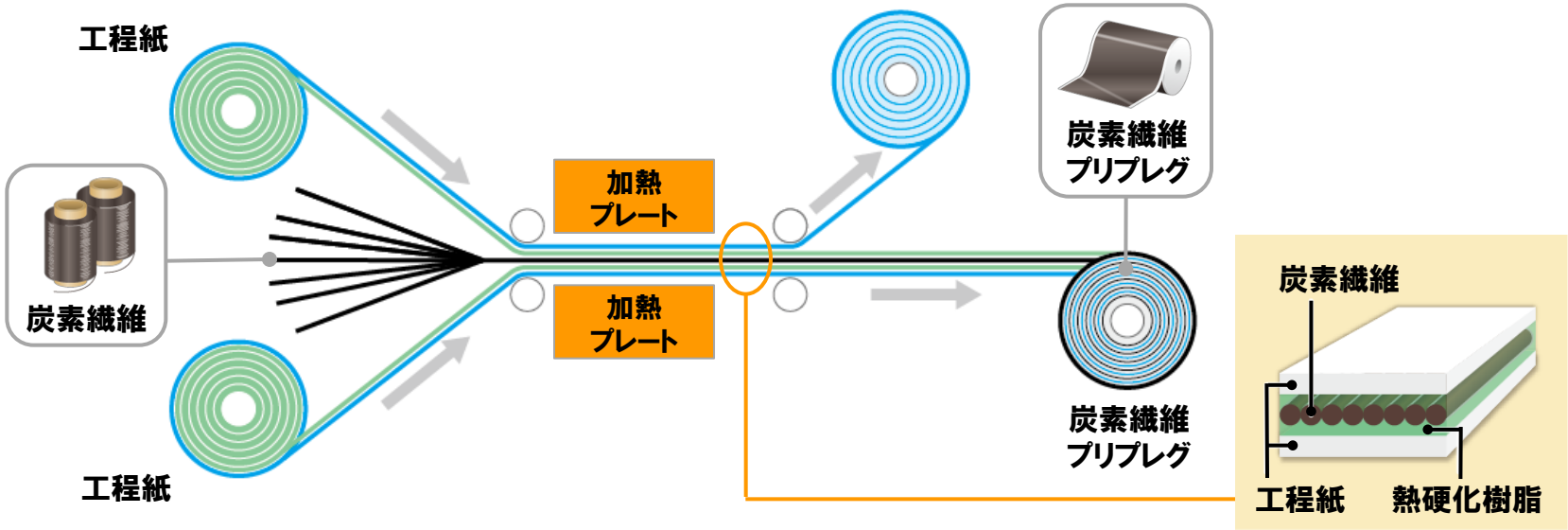
●炭素繊維複合材料用工程紙

・炭素繊維をシート状に並べて樹脂で固めた複合材料「炭素繊維プリプレグ」をつくる際に台紙として使用

・炭素繊維プリプレグは、テニスラケットやゴルフシャフト、釣り竿などのスポーツ・レジャー用品のほか、航空機の機体などに使用され、需要が拡大している

主な特徴
・樹脂塗工適性
・耐熱性
・強度
・表裏の剥離力バランス

■炭素繊維プリプレグの製造工程

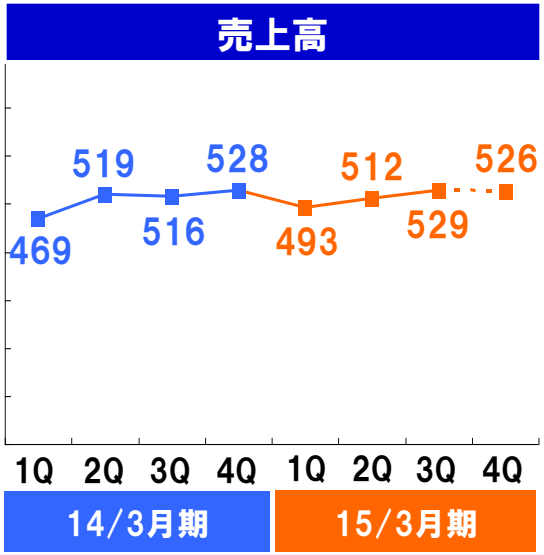


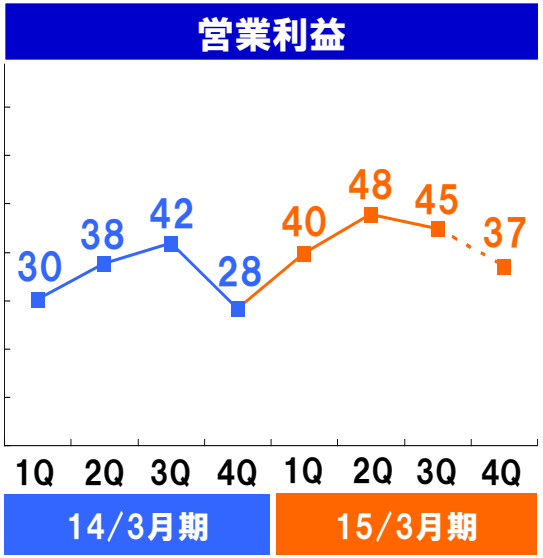
2015年3月期通期　連結業績の見通し

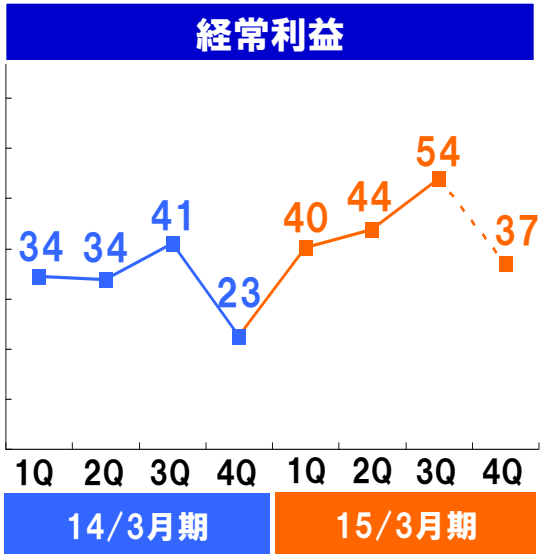
（単位：億円）

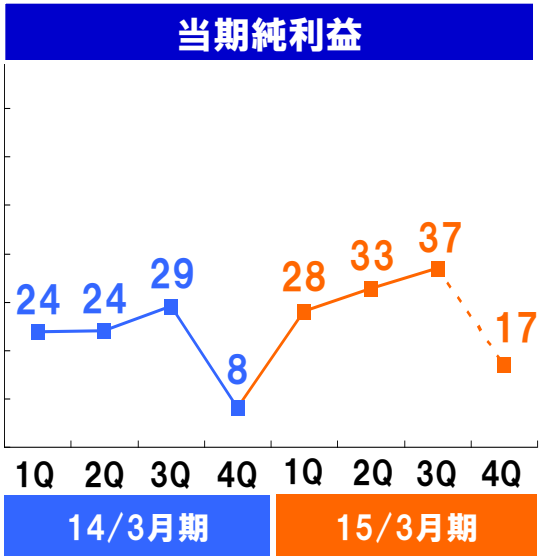
	15/3月期 通期予想	14/3月期 通期実績	増減 （増減率）
売上高	2,060	2,032	28 （1.4%）
営業利益	170	138	32 （23.5%）
経常利益	175	132	43 （32.9%）
当期純利益	115	85	30 （35.3%）

（単位：億円）









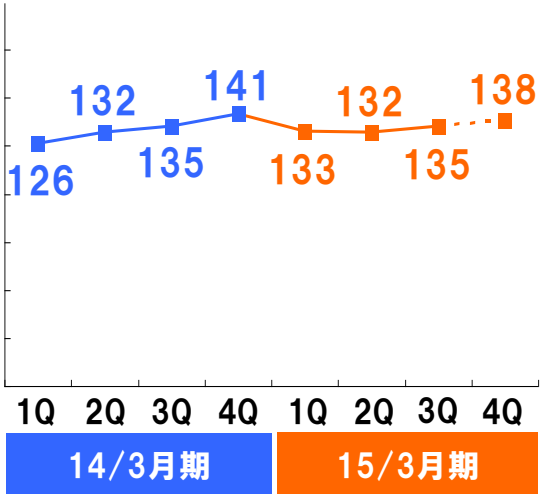
印刷材・産業工材関連

（単位：億円）

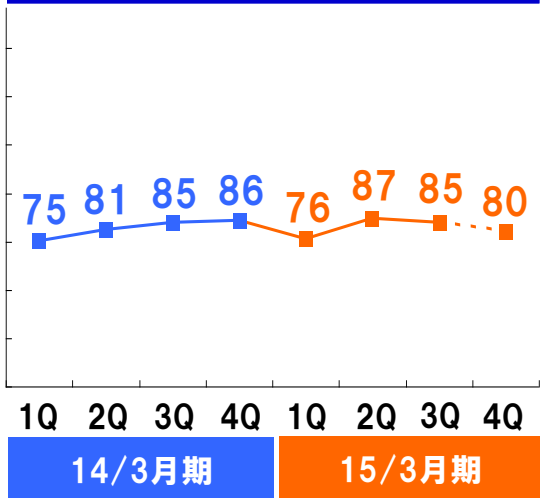
印刷材・産業工材関連	15/3月期 通期予想	14/3月期 通期実績	増減（増減率）
印刷・情報材事業部門	538	535	3（0.5%）
産業工材事業部門	328	327	1（0.2%）
セグメント売上高	866	863	3（0.4%）
セグメント営業利益	28	23	5（22.3%）

（単位：億円）

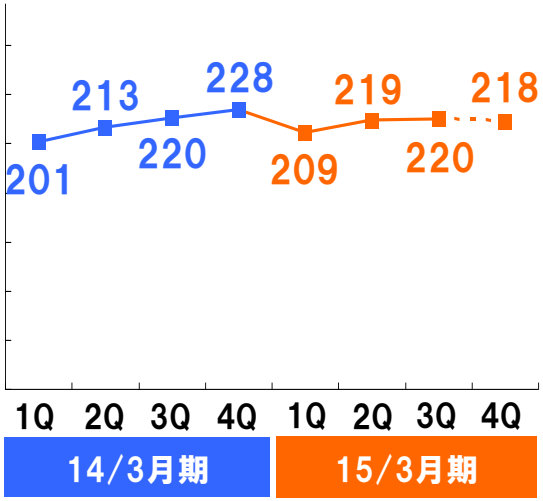
印刷・情報材事業部門　売上高



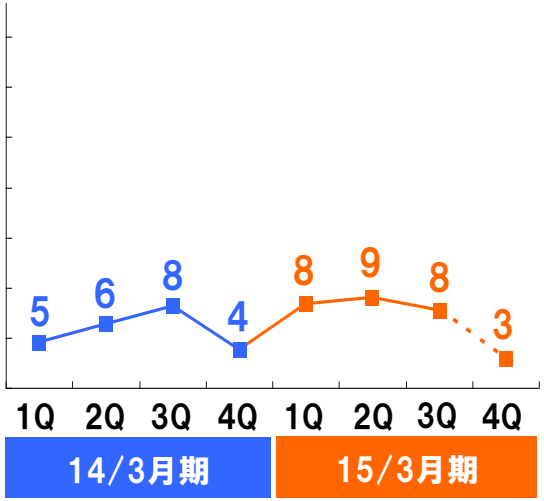
産業工材事業部門　売上高



セグメント売上高



セグメント営業利益



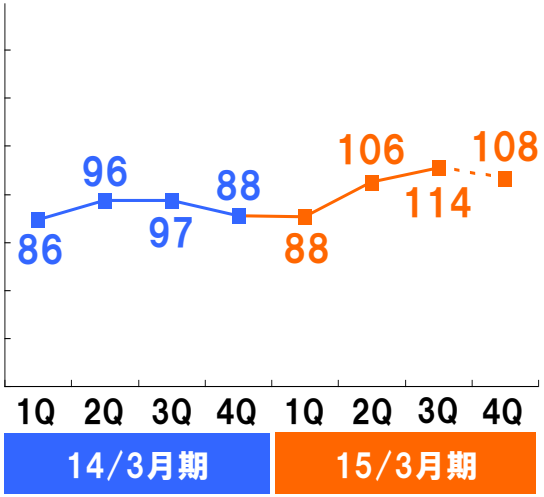
電子・光学関連

（単位：億円）

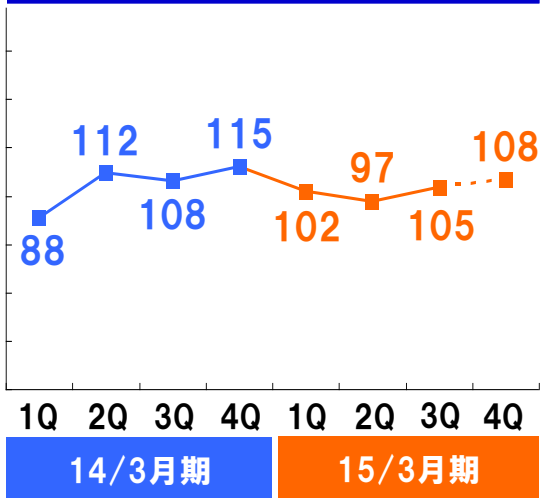
電子・光学関連	15/3月期 通期予想	14/3月期 通期実績	増減 （増減率）
アドバンストマテリアルズ事業部門	416	368	48 （13.1%）
オプティカル材事業部門	412	424	▲12 （▲2.7%）
セグメント売上高	828	791	37 （4.6%）
セグメント営業利益	102	68	34 （49.0%）

（単位：億円）

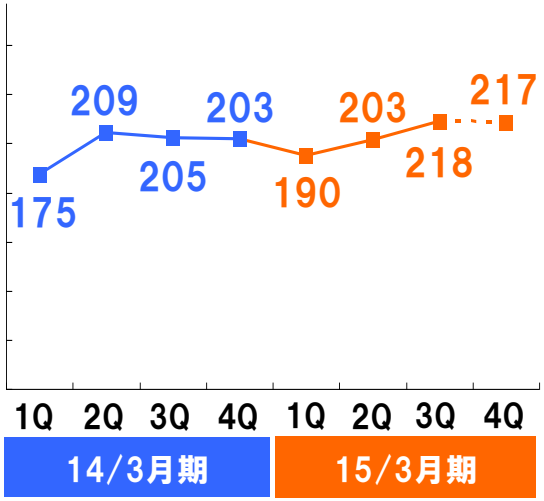
アドバンストマテリアルズ事業部門　売上高



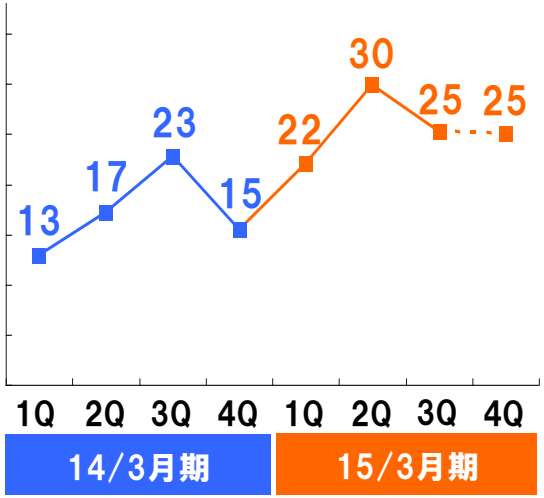
オプティカル材事業部門　売上高



セグメント売上高



セグメント営業利益



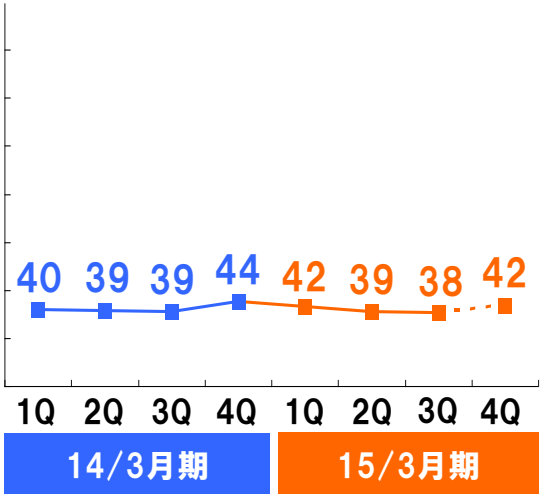
洋紙・加工材関連

（単位：億円）

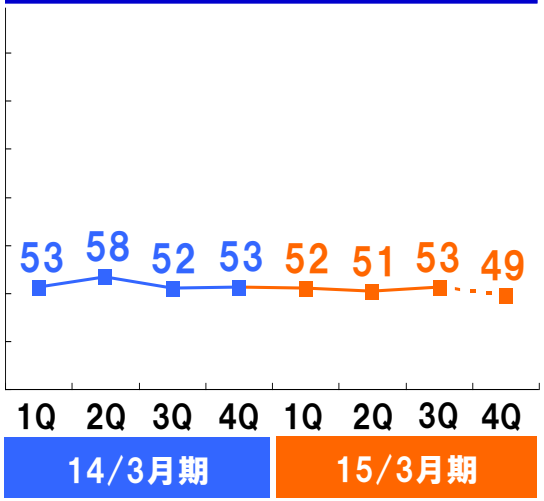
洋紙・加工材関連	15/3月期 通期予想	14/3月期 通期実績	増減 （増減率）
洋紙 事業部門	161	161	▲ 0 （▲0.2%）
加工材 事業部門	205	217	▲12 （▲5.5%）
セグメント 売上高	366	378	▲12 （▲3.3%）
セグメント 営業利益	40	46	▲ 6 （▲13.9%）

（単位：億円）

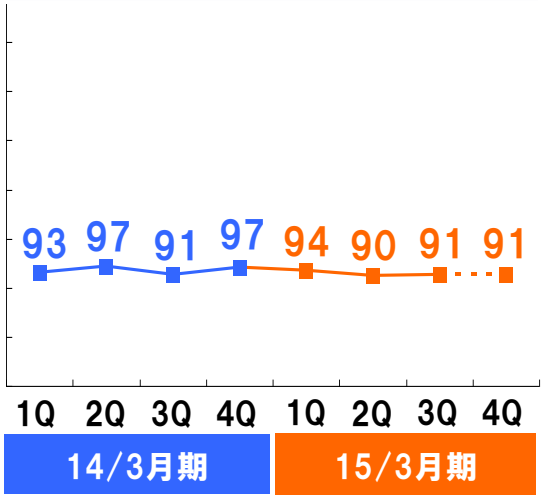
洋紙事業部門　売上高



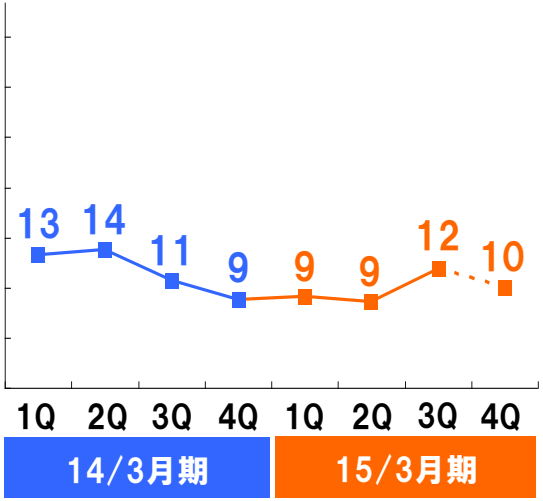
加工材事業部門　売上高



セグメント売上高

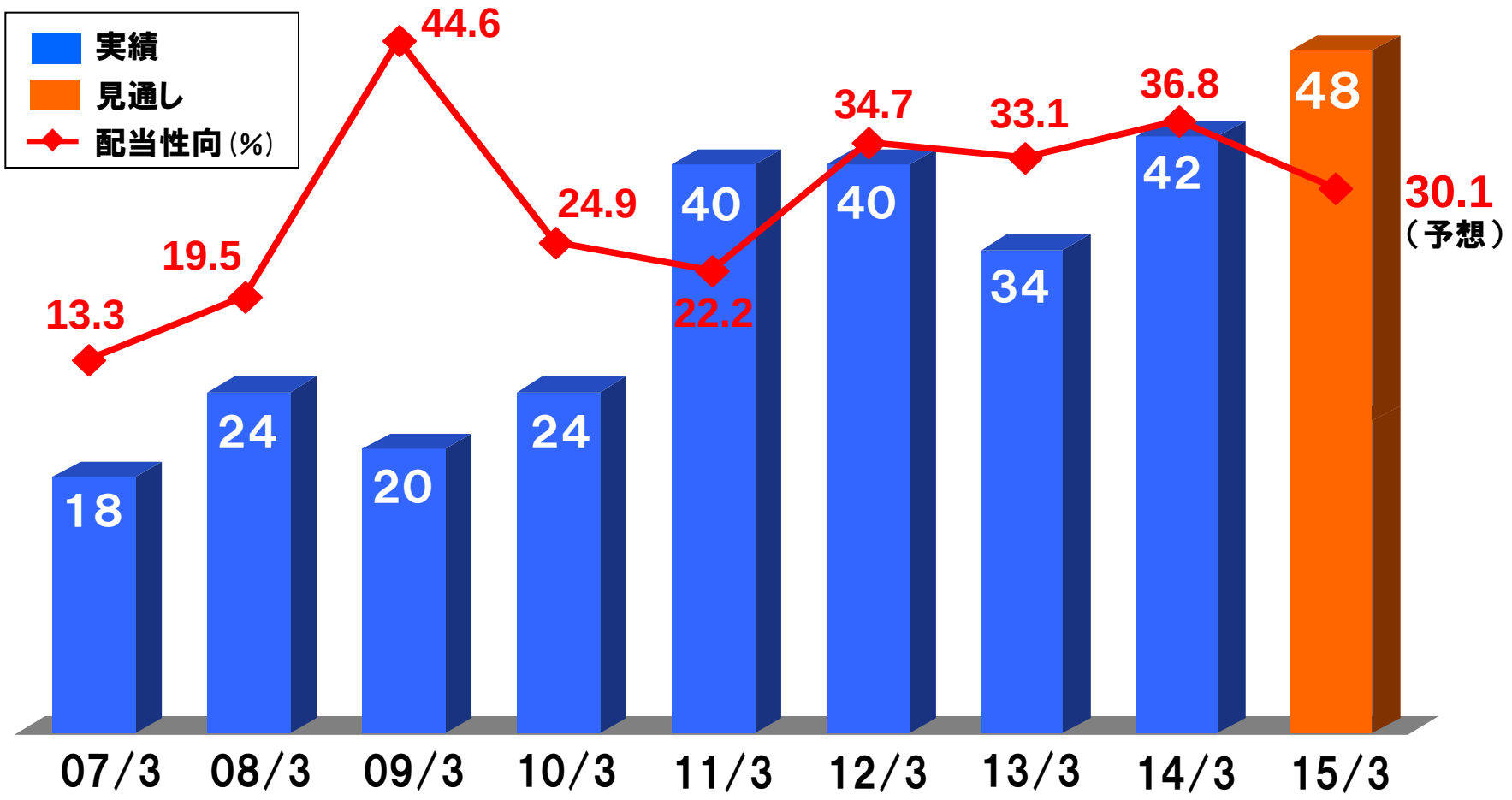


セグメント営業利益



配当

●1株当たり配当金推移（円）



中期経営計画

LIP-2016 LINTEC INNOVATION PLAN

名　　称	LIP-2016（LINTEC INNOVATION PLAN 2016）
期　　間	2014年4月～2017年3月
基本方針	攻めの経営と間断なきイノベーションで成長軌道を取り戻す
重点テーマ	1. グローバル展開のさらなる推進 2. 次世代を担う革新的新製品の創出 3. 強靭な企業体質への変革 4. 戦略的M＆Aの推進 5. 人財の育成

最終年度の主要数値目標（連結ベース）

■売上高	2,400億円	■売上高営業利益率	8％以上
■営業利益	200億円	■ROE（自己資本利益率）	8％以上

本資料および当社製品などに関するお問い合わせ先

リンテック株式会社　広報・IR室

〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
TEL.03-5248-7741

本資料に掲載されている業績見通しに関する内容につきましては、本資料の作成日現在において想定できる経済情勢、市場動向および計画などに基づき作成したものであり、その内容の正確性を保証したり、将来の計画数値、施策の実現を確約したりするものではありません。したがって、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。